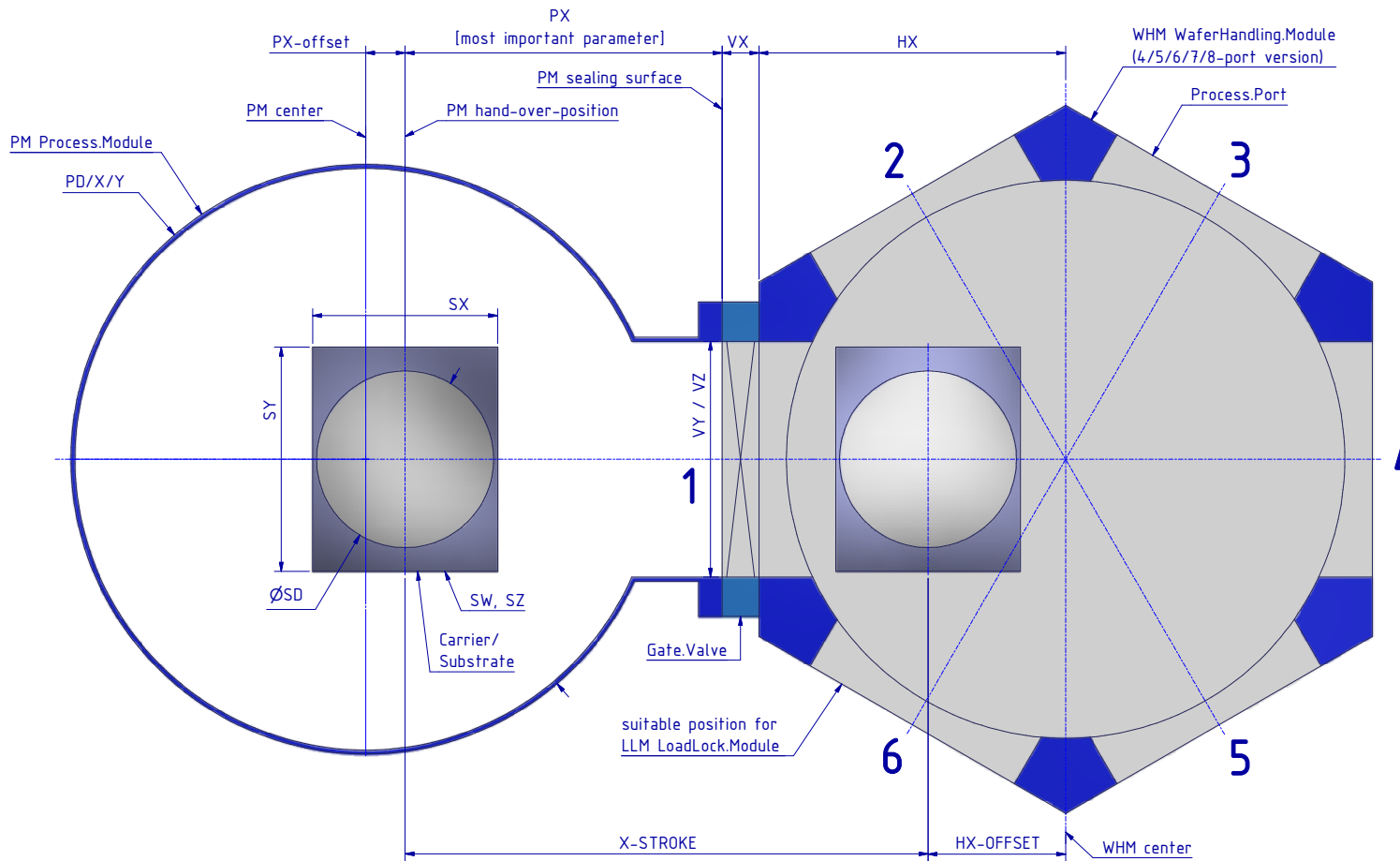


Process.Module PM#1

WHM WaferHandling.Module 4/5/6/7/8 ports



REQUIRED.DIMENSIONS:

Substrate/Carrier.Dimensions:

- rectangular: SX and SY
- circular: ØSD
- thickness: SZ
- substrate/carrier weight (LOAD): SW

Cluster.Layout:

- number of process ports, e.g. 6 pcs. = WHM6X

Process.Dimensions:

- [very important parameter]
- PX = hand-over-position inside process module to outer sealing surface (w/o gate)

Valve.Dimensions:

- VX = valve thickness
- VY = valve width (opening)
- VZ = valva high (opening)

Additional.Dimensions (if available):

- PD/X/Y = dimensions of process chamber

Informal.Dimensions (defined by Adenso):

- HX = sealing surface to center (WHM)

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715	$+0,3$ $+0,1$ $-0,1$	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768	Prüfmaß nach DIN 461-11
1	Bohrungen / holes	0,1 mm		Längen und Winkelmaß	Teilerungsgrundsatz nach ISO 895
1	Gewinde / threads	0,1 mm		Form und Lage	Allg.-Teil-Schweißkonst. nach DIN ISO 2768
1	Passungen / fits	0,01 mm		Längen und Winkelmaß	Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung) DIN EN ISO 5817 c
projection ISO 128 - method 1		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Maßstab: 1 : 5	Masse: 6,8 kg
		Dichtfläche RZ 6,3		Halbzeug:	Material/Oberfläche: Allgemein
		Datum Name		Benennung	
		Gezeichnet 20.02.2013 BC		WHM	
		Freigegeben		WaferHandling.Module required dimensions	
		Adenso solutions you need		Zeichnungsnr. 188-200000-88	
		Status Änderungen Datum Name 188-200000-88.rdw		Revision 02	
		Ersatz für		1 / 1 A2	
		Ersatz durch			